Dell EMC PowerEdge C6400
기술 사양

규정 모델: E43S Series
규정 유형: E43S001
December 2020
개정 A03

참고, 주의 및 경고

노트: 참고"는 제품을 보다 효율적으로 사용하는 데 도움이 되는 중요 정보를 제공합니다.

주의: 주의사항은 하드웨어의 손상 또는 데이터 유실 위험을 설명하며, 이러한 문제를 방지할 수 있는 방법을 알려줍니다.

경고: 경고는 재산 손실, 신체적 상해 또는 사망 위험이 있음을 알려줍니다.

© 2017 - 2020 Dell Inc. or its subsidiaries. All rights reserved. Dell, EMC 및 기타 상표는 Dell Inc. 또는 그 자회사의 상표입니다. 다른 상표는 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.

목차

장 1: 기술 사양 4
Dell EMC PowerEdge C6400 인클로저 크기 4
섀시 중량 5
지원되는 운영 체제 5
PSU 사양 5
섀시 관리 보드 사양 6
드라이브 및 스토리지 사양 6
미드플레인 사양 7
환경 사양 7
표준 작동 온도 사양 7
확대된 작동 온도 사양 16
미세 먼지 및 가스 오염 사양 17
최대 진동 사양 17
최대 충격 사양 18
최대 고도 사양 18
Fresh Air 작동 18

1

기술 사양

이 섹션에는 시스템의 기술 및 환경 사양이 설명되어 있습니다.

주제:

- Dell EMC PowerEdge C6400 인클로저 크기
- 섀시 중량
- 지원되는 운영 체제
- PSU 사양
- 섀시 관리 보드 사양
- 드라이브 및 스토리지 사양
- 미드플레인 사양
- 환경 사양

Dell EMC PowerEdge C6400 인클로저 크기

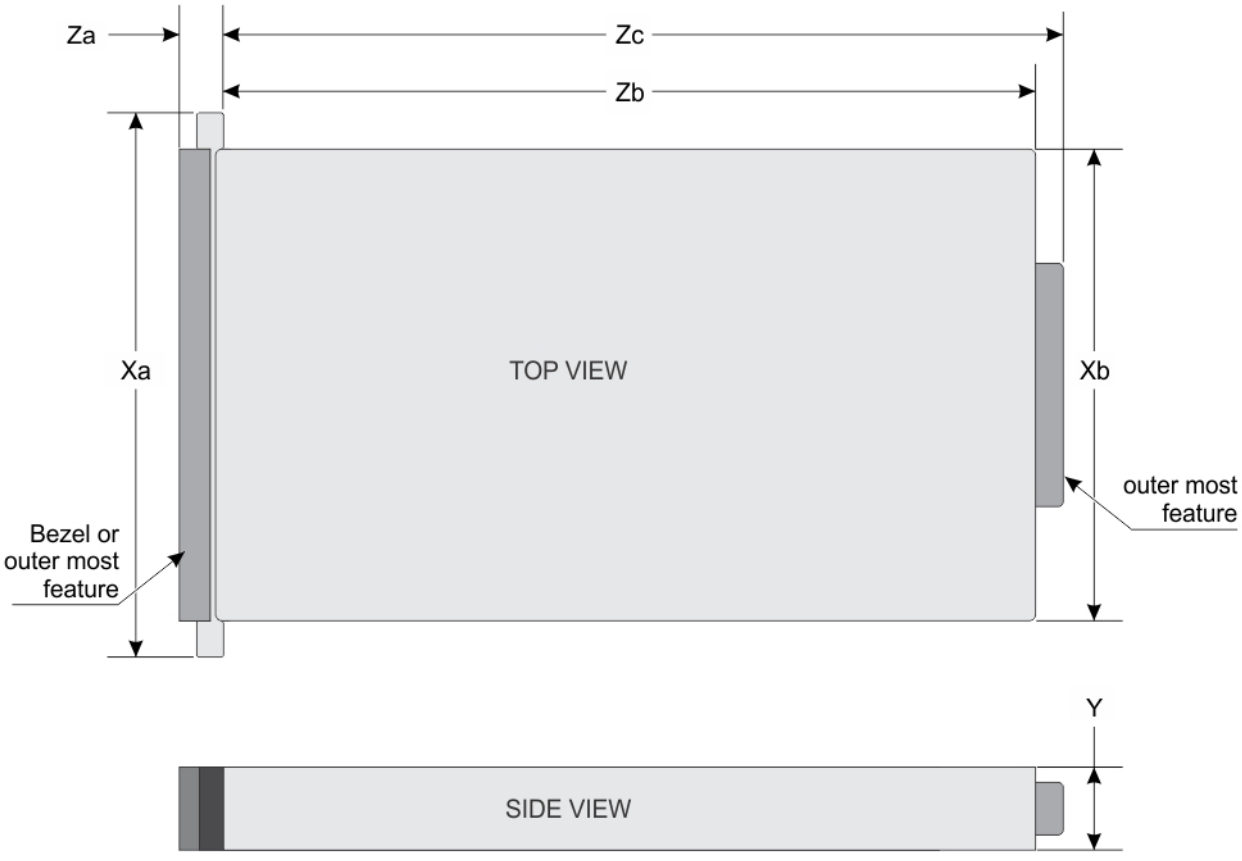

그림 1 . PowerEdge C6400 인클로저 크기

표 1. PowerEdge C6400 인클로저 크기

Xa	Xb	Y	Za	Zb	Zc
482.6mm(19")	448mm(17.63")	86.8mm(3.41")	26.8mm(1.05")	763.2mm(30.28")	797.3mm(31.38")

섀시 중량

표 2. PowerEdge C6420 슬레드가 있는 Dell EMC PowerEdge C6400 엔클로저의 섀시 중량

시스템	최대 중량(모든 슬레드 및 드라이브 포함)
12개의 3.5" 하드 드라이브 시스템	43.62Kg(96.16lb)
24개의 2.5" 하드 드라이브 시스템	41.46Kg(91.40lb)
백플레인이 없는 시스템	34.56Kg(76.19lb)

지원되는 운영 체제

Dell EMC PowerEdge C6400은 다음 운영 체제를 지원합니다.

- Canonical Ubuntu LTS
- Citrix XenServer
- Microsoft Windows Server(Hyper-V 포함)
- Red Hat Enterprise Linux
- SUSE Linux Enterprise Server
- VMware ESXi

노트: 특정 버전 및 추가 사항에 대한 자세한 정보는 https://www.dell.com/support/home/drivers/supportedos/poweredge-c6400을 참조하십시오.

PSU 사양

Dell EMC PowerEdge C6400 엔클로저는 2개의 AC PSU(Power Supply Unit)를 지원합니다.

표 3. PSU 사양

PSU 와트	등급	열 손실(최대)	주파수	전압	최대 입력 전류
2400W AC	플래티넘	9000BTU/hr	50/60Hz	100~240V AC, 자동 범위 조정	14A~16A
2000W AC	플래티넘	7500 BTU/hr	50/60Hz	100~240V AC, 자동 범위 조정	11.5A
1600W AC	플래티넘	6000 BTU/hr	50/60Hz	100~240V AC, 자동 범위 조정	10 A

노트: 열 손실은 PSU 와트 정격을 사용하여 계산합니다.

노트: 또한, 이 시스템은 상간 전압 240V를 초과하지 않는 IT 전원 시스템에 연결하도록 설계되어 있습니다.

노트: 2400W AC PSU 장착 시스템이 저전압 100~120V AC에서 작동하는 경우 PSU당 정격 전원은 1400W로 낮아집니다.

노트: 2000W AC PSU 장착 시스템이 저전압 100~120V AC에서 작동하는 경우 PSU당 정격 전원은 1000W로 낮아집니다.

노트: 1600W AC PSU 장착 시스템이 저전압 100~120V AC에서 작동하는 경우 PSU당 정격 전원은 800W로 낮아집니다.

섀시 관리 보드 사양

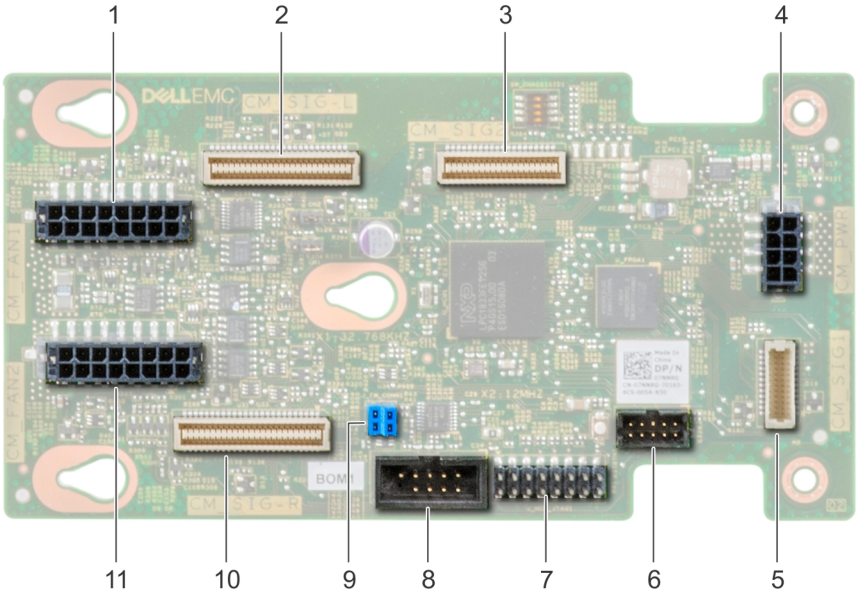

그림 2 . 섀시 관리 보드 사양

1. 팬 1 및 2의 팬 케이지 1 커넥터
2. 왼쪽 미드플레인 신호 케이블
3. 백플레인과 연결되는 섀시 관리 보드 신호 케이블
4. PIB의 섀시 관리 보드 전원 커넥터
5. PIB와 연결되는 섀시 관리 보드 신호 케이블
6. FPGA 커넥터
7. MCU 커넥터
8. COM 커넥터
9. 펌웨어 점퍼
10. 오른쪽 미드플레인 신호 케이블
11. 팬 3 및 4용 팬 케이지 2 커넥터

드라이브 및 스토리지 사양

Dell EMC PowerEdge C6400 엔클로저는 SAS 및 SATA 하드 드라이브와 SSD(Solid State Drive)를 지원합니다.

표 4. Dell EMC PowerEdge C6400 엔클로저에 대해 지원되는 드라이브 옵션

엔클로저에 장착 가능한 드라이브 최대 개수	슬레드당 할당 가능한 드라이브 최대 개수
12개의 8.89cm(3.5인치) 드라이브 시스템	슬레드당 3개의 SAS 또는 SATA 하드 드라이브와 SSD
24개의 6.35cm(2.5인치) 드라이브 시스템	슬레드당 6개의 SAS 또는 SATA 하드 드라이브와 SSD
NVMe를 포함하는 24개의 6.35cm(2.5인치) 드라이브 시스템	NVMe 백플레인은 다음 구성 중 하나를 지원합니다. • 슬레드당 2개의 NVMe 드라이브 및 4개의 SAS 또는 SATA 하드 드라이브와 SSD • 슬레드당 6개의 SAS 또는 SATA 하드 드라이브와 SSD
M.2 SATA 드라이브(옵션)	M.2 SATA 카드의 지원 용량은 최대 240GB입니다. **노트:** M.2 SATA 카드는 x16 라이저 슬롯(슬롯 5)에 설치할 수 있습니다.
부팅용 SD 카드(옵션)(최대 64GB)	각 슬레드의 PCIe 라이저당 1개

표 5. M.2 SATA 드라이브에서 지원되는 RAID 옵션

옵션	RAID를 포함하지 않는 단일 M.2 SATA 드라이브	하드웨어 RAID를 포함하는 이중 M.2 SATA 드라이브
하드웨어 RAID	아니오	예

표 5. M.2 SATA 드라이브에서 지원되는 RAID 옵션 (계속)

옵션	RAID를 포함하지 않는 단일 M.2 SATA 드라이브	하드웨어 RAID를 포함하는 이중 M.2 SATA 드라이브
RAID 모드	N/A(해당 없음)	RAID 1
지원되는 드라이브의 수	1	2
지원되는 CPU	CPU 1	CPU 1 및 CPU 2

미드플레인 사양

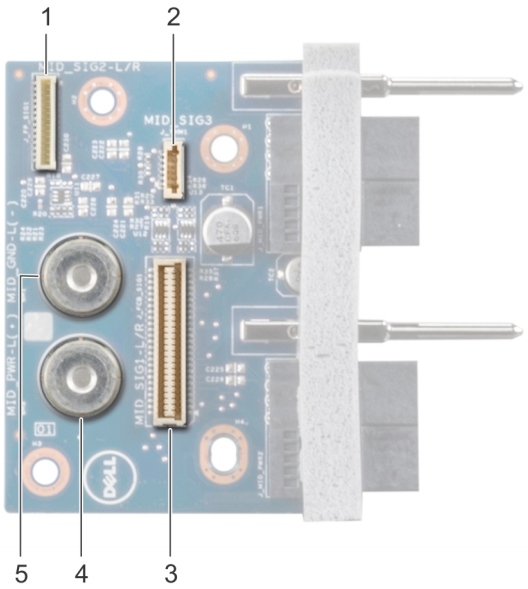

그림 3 . 미드플레인 사양

1. 미드플레인 신호 커넥터 2
2. 열 센서 케이블 커넥터
3. 섀시 관리 보드 케이블 커넥터
4. 미드플레인 +12V 전원 케이블 커넥터
5. 미드플레인 전원 케이블 접지 커넥터

환경 사양

아래 섹션에는 시스템 환경 사양에 대한 정보가 나와 있습니다.

노트: 환경 인증에 대한 추가 정보는 www.dell.com/poweredgemanuals에서 매뉴얼 및 문서의 제품 환경 데이터 시트를 참조하십시오.

표준 작동 온도 사양

노트:

1. 제공되지 않음: Dell EMC에서 제공되지 않는 구성임을 나타냅니다.
2. 지원되지 않음: 열 지원이 되지 않는 구성임을 나타냅니다.

노트: Mellanox DP LP 카드 및 인텔 Rush Creek 카드를 제외하고 주위 온도가 이 표에 나열된 최대 연속 운영 온도와 같거나 낮을 경우 충분한 열 마진으로 DIMM, 통신 카드, M.2 SATA 및 PERC 카드를 포함한 모든 구성 요소를 지원할 수 있습니다.

표 6. 표준 작동 온도 사양

표준 작동 온도	사양
온도 범위(950 m 또는 3117피트 미만의 고도에서)	장비가 직사광선을 받지 않는 상태에서 10°C~35°C(50°F~95°F)

노트: 일부 구성에는 보다 낮은 주위 온도가 필요합니다. 자세한 정보는 다음 표를 참조하십시오.

표 7. 비패브릭 듀얼 프로세서 구성에 대한 최대 연속 운영 온도

TDP(W)	프로세서 모델	방열판 모델	최대 메모리/프로세서	3.5" 섀시			2.5" 섀시						비 BP 섀시
				12개의 드라이브	8개의 드라이브	4개의 드라이브	24개의 드라이브	20개의 드라이브	16개의 드라이브	12개의 드라이브	8개의 드라이브	4개의 드라이브	N/A(해당 없음)
205W	8280	CPU1: FMM2M | CPU2: V2DRD	CPU1: 6 | CPU2: 8	지원되지 않음(2°C)	지원되지 않음(10°C)	지원되지 않음(11°C)	지원되지 않음(19°C)	20	21	21	21	21	30
	8280L	CPU1: FMM2M | CPU2: V2DRD	CPU1: 6 | CPU2: 8					20	21	21	21	21	30
	8280M	CPU1: FMM2M | CPU2: V2DRD	CPU1: 6 | CPU2: 8					20	21	21	21	21	30
	8270	CPU1: FMM2M | CPU2: V2DRD	CPU1: 6 | CPU2: 8					20	21	21	21	21	30
	8268	CPU1: FMM2M | CPU2: V2DRD	CPU1: 6 | CPU2: 8					20	21	21	21	21	30
200W	6254	CPU1: FMM2M | CPU2: V2DRD	CPU1: 6 | CPU2: 8	지원되지 않음(6°C)	지원되지 않음(14°C)	지원되지 않음(15°C)	20	21	22	22	22	22	30
165W	8276	CPU1: JYKMM | CPU2: V2DRD	CPU1: 8 | CPU2: 8	지원되지 않음(11°C)	지원되지 않음(18°C)	지원되지 않음(19°C)	30	30	30	30	30	35	35
	8276L	CPU1: JYKMM | CPU2: V2DRD	CPU1: 8 | CPU2: 8				30	30	30	30	30	35	35
	8276M	CPU1: JYKMM | CPU2: V2DRD	CPU1: 8 | CPU2: 8				30	30	30	30	30	35	35
	8260	CPU1: JYKMM | CPU2: V2DRD	CPU1: 8 | CPU2: 8				30	30	30	30	30	35	35

표 7. 비패브릭 듀얼 프로세서 구성에 대한 최대 연속 운영 온도 (계속)

TDP(W)	프로세서 모델	방열판 모델	최대 메모리/프로세서	3.5" 섀시			2.5" 섀시						비 BP 섀시
				12개의 드라이브	8개의 드라이브	4개의 드라이브	24개의 드라이브	20개의 드라이브	16개의 드라이브	12개의 드라이브	8개의 드라이브	4개의 드라이브	N/A(해당 없음)
	8260L	CPU1: JYKMM | CPU2: V2DRD	CPU1: 8 | CPU2: 8				30	30	30	30	30	35	35
	8260M	CPU1: JYKMM | CPU2: V2DRD	CPU1: 8 | CPU2: 8				30	30	30	30	30	35	35
	8260C	CPU1: JYKMM | CPU2: V2DRD	CPU1: 8 | CPU2: 8				30	30	30	30	30	35	35
150 W	6252	CPU1: JYKMM | CPU2: V2DRD	CPU1: 8 | CPU2: 8	지원되지 않음 (14°C)	21	23	30	30	30	30	30	35	35
	6248	CPU1: JYKMM | CPU2: V2DRD	CPU1: 8 | CPU2: 8		21	23	30	30	30	30	30	35	35
	6240	CPU1: JYKMM | CPU2: V2DRD	CPU1: 8 | CPU2: 8		21	23	30	30	30	30	30	35	35
	6242	CPU1: JYKMM | CPU2: V2DRD	CPU1: 8 | CPU2: 8		21	23	30	30	30	30	30	35	35
	6244	CPU1: FMM2M | CPU2: V2DRD	CPU1: 6 | CPU2: 8		21	23	30	30	30	30	30	35	35
	6240C	CPU1: FMM2M | CPU2: V2DRD	CPU1: 6 | CPU2: 8		21	23	30	30	30	30	30	35	35
125W	6230	CPU1: JYKMM | CPU2: V2DRD	CPU1: 8 | CPU2: 8	25	30	30	30	30	35	35	35	35	35
	5220	CPU1: JYKMM | CPU2: V2DRD	CPU1: 8 | CPU2: 8	25	30	30	30	30	35	35	35	35	35
	5218	CPU1: JYKMM | CPU2: V2DRD	CPU1: 8 | CPU2: 8	25	30	30	30	30	35	35	35	35	35

표 7. 비패브릭 듀얼 프로세서 구성에 대한 최대 연속 운영 온도 (계속)

TDP(W)	프로세서 모델	방열판 모델	최대 메모리/프로세서	3.5" 섀시			2.5" 섀시						비 BP 섀시
				12개의 드라이브	8개의 드라이브	4개의 드라이브	24개의 드라이브	20개의 드라이브	16개의 드라이브	12개의 드라이브	8개의 드라이브	4개의 드라이브	N/A(해당 없음)
	5218B	CPU1: JYKMM | CPU2: V2DRD	CPU1: 8 | CPU2: 8	25	30	30	30	30	35	35	35	35	35
	8253	CPU1: JYKMM | CPU2: V2DRD	CPU1: 8 | CPU2: 8	25	30	30	30	30	35	35	35	35	35
	6238T	CPU1: JYKMM | CPU2: V2DRD	CPU1: 8 | CPU2: 8	25	30	30	30	30	35	35	35	35	35
	6230N	CPU1: JYKMM | CPU2: V2DRD	CPU1: 8 | CPU2: 8	25	30	30	30	30	35	35	35	35	35
115W	5217	CPU1: FMM2M | CPU2: V2DRD	CPU1: 6 | CPU2: 8	25	30	30	30	30	35	35	35	35	35
105W	5218T	CPU1: FMM2M | CPU2: V2DRD	CPU1: 6 | CPU2: 8	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	5218N	CPU1: FMM2M | CPU2: V2DRD	CPU1: 6 | CPU2: 8	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	5222	CPU1: FMM2M | CPU2: V2DRD	CPU1: 6 | CPU2: 8	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	8256	CPU1: FMM2M | CPU2: V2DRD	CPU1: 6 | CPU2: 8	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35
100 W	4216	CPU1: JYKMM | CPU2: V2DRD	CPU1: 8 | CPU2: 8	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35
85W	5215	CPU1: JYKMM | CPU2: V2DRD	CPU1: 8 | CPU2: 8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	5215M	CPU1: JYKMM | CPU2: V2DRD	CPU1: 8 | CPU2: 8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35

표 7. 비패브릭 듀얼 프로세서 구성에 대한 최대 연속 운영 온도 (계속)

TDP(W)	프로세서 모델	방열판 모델	최대 메모리/프로세서	3.5" 섀시			2.5" 섀시						비 BP 섀시
				12개의 드라이브	8개의 드라이브	4개의 드라이브	24개의 드라이브	20개의 드라이브	16개의 드라이브	12개의 드라이브	8개의 드라이브	4개의 드라이브	N/A(해당 없음)
	5215L	CPU1: JYKMM | CPU2: V2DRD	CPU1: 8 | CPU2: 8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	4215	CPU1: JYKMM | CPU2: V2DRD	CPU1: 8 | CPU2: 8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	4214	CPU1: JYKMM | CPU2: V2DRD	CPU1: 8 | CPU2: 8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	4214C	CPU1: JYKMM | CPU2: V2DRD	CPU1: 8 | CPU2: 8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	4210	CPU1: JYKMM | CPU2: V2DRD	CPU1: 8 | CPU2: 8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	4208	CPU1: JYKMM | CPU2: V2DRD	CPU1: 8 | CPU2: 8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	3204	CPU1: JYKMM | CPU2: V2DRD	CPU1: 8 | CPU2: 8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
70W	4209T	CPU1: JYKMM | CPU2: V2DRD	CPU1: 8 | CPU2: 8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35

표 8. 비패브릭 단일 프로세서 구성에 대한 최대 연속 운영 온도

TDP(W)	프로세서 모델	방열판 모델	최대 메모리/프로세서	3.5" 섀시			2.5" 섀시						비 BP 섀시
				12개의 드라이브	8개의 드라이브	4개의 드라이브	24개의 드라이브	20개의 드라이브	16개의 드라이브	12개의 드라이브	8개의 드라이브	4개의 드라이브	N/A(해당 없음)
205W	8280	CPU1: FMM2M	CPU1: 6	30	30	30	35	35	35	35	35	35	35
	8280L	CPU1: FMM2M	CPU1: 6	30	30	30	35	35	35	35	35	35	35
	8280M	CPU1: FMM2M	CPU1: 6	30	30	30	35	35	35	35	35	35	35
	8270	CPU1: FMM2M	CPU1: 6	30	30	30	35	35	35	35	35	35	35

표 8. 비패브릭 단일 프로세서 구성에 대한 최대 연속 운영 온도 (계속)

TDP(W)	프로세서 모델	방열판 모델	최대 메모리/프로세서	3.5" 섀시			2.5" 섀시						비 BP 섀시
				12개의 드라이브	8개의 드라이브	4개의 드라이브	24개의 드라이브	20개의 드라이브	16개의 드라이브	12개의 드라이브	8개의 드라이브	4개의 드라이브	N/A(해당 없음)
	8268	CPU1: FMM2M	CPU1: 6	30	30	30	35	35	35	35	35	35	35
200W	6254	CPU1: FMM2M	CPU1: 6	30	30	30	35	35	35	35	35	35	35
165W	6212U	CPU1: JYKMM	CPU1: 8	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	8276	CPU1: JYKMM	CPU1: 8	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	8276L	CPU1: JYKMM	CPU1: 8	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	8276M	CPU1: JYKMM	CPU1: 8	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	8260	CPU1: JYKMM	CPU1: 8	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	8260L	CPU1: JYKMM	CPU1: 8	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	8260M	CPU1: JYKMM	CPU1: 8	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	8260C	CPU1: JYKMM	CPU1: 8	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35
150 W	6210U	CPU1: JYKMM	CPU1: 8	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	6252	CPU1: JYKMM	CPU1: 8	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	6248	CPU1: JYKMM	CPU1: 8	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	6240	CPU1: JYKMM	CPU1: 8	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	6242	CPU1: JYKMM	CPU1: 8	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	6244	CPU1: FMM2M	CPU1: 6	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	6240C	CPU1: FMM2M	CPU1: 6	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35
125W	6230	CPU1: JYKMM	CPU1: 8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	5220	CPU1: JYKMM	CPU1: 8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	5218	CPU1: JYKMM	CPU1: 8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	5218B	CPU1: JYKMM	CPU1: 8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35

표 8. 비패브릭 단일 프로세서 구성에 대한 최대 연속 운영 온도 (계속)

TDP(W)	프로세서 모델	방열판 모델	최대 메모리/프로세서	3.5" 섀시			2.5" 섀시						비 BP 섀시
				12개의 드라이브	8개의 드라이브	4개의 드라이브	24개의 드라이브	20개의 드라이브	16개의 드라이브	12개의 드라이브	8개의 드라이브	4개의 드라이브	N/A(해당 없음)
	8253	CPU1: JYKMM	CPU1: 8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	6238T	CPU1: JYKMM	CPU1: 8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	6230N	CPU1: JYKMM	CPU1: 8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
115W	5217	CPU1: FMM2M	CPU1: 6	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35
105W	5218T	CPU1: FMM2M	CPU1: 6	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	5218N	CPU1: FMM2M	CPU1: 6	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	5222	CPU1: FMM2M	CPU1: 6	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	8256	CPU1: FMM2M	CPU1: 6	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35
100 W	4216	CPU1: JYKMM	CPU1: 8	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35
85W	5215	CPU1: JYKMM	CPU1: 8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	5215M	CPU1: JYKMM	CPU1: 8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	5215L	CPU1: JYKMM	CPU1: 8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	4215	CPU1: JYKMM	CPU1: 8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	4214	CPU1: JYKMM	CPU1: 8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	4214C	CPU1: JYKMM	CPU1: 8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	4210	CPU1: JYKMM	CPU1: 8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	4208	CPU1: JYKMM	CPU1: 8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	3204	CPU1: JYKMM	CPU1: 8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
70W	4209T	CPU1: JYKMM	CPU1: 8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35

표 9. 활성(옵티컬) 연결을 포함하는 Mellanox Navi 듀얼 포트 카드 관련 구성 제한 사항

TDP(W)	3.5" 섀시			2.5" 섀시				비 BP 섀시
	12개의 HDD	8개의 HDD	4개의 HDD	24개의 HDD	16개의 HDD	8개의 HDD	4개의 HDD	N/A(해당 없음)
205W	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	23
200W	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	23
173W	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	24	24	28
165W	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	24	25	25	26	29
160W	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	24	25	26	26	30
150 W	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	26	27	28	28	31
140W	지원되지 않음	23	25	28	29	29	30	33
135W	지원되지 않음	24	25	29	30	30	31	33
130 W	지원되지 않음	24	26	30	31	31	31	34
125W	20	25	27	30	31	32	32	35
115W	21	27	28	32	33	34	34	35 초과
113W	21	27	28	32	33	34	34	35 초과
105W	22	28	30	34	35	35 초과	35 초과	35 초과
85W	23	32	33	35 초과	35 초과	35 초과	35 초과	35 초과
70W	25	34	35 초과	35 초과	35 초과	35 초과	35 초과	35 초과

표 10. 인텔 Rush Creek 구성 제한 사항

TDP(W)	3.5" 섀시			2.5" 섀시				비 BP 섀시
	12개의 HDD	8개의 HDD	4개의 HDD	24개의 HDD	16개의 HDD	8개의 HDD	4개의 HDD	N/A(해당 없음)
205W	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	20	20	23
200W	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	21	21	24
173W	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	20	20	23	24	28
165W	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	22	22	24	25	29
160W	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	22	22	24	26	29
150 W	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	24	24	26	27	30
140W	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	26	26	27	28	31

표 10. 인텔 Rush Creek 구성 제한 사항 (계속)

TDP(W)	3.5" 섀시			2.5" 섀시				비 BP 섀시
	12개의 HDD	8개의 HDD	4개의 HDD	24개의 HDD	16개의 HDD	8개의 HDD	4개의 HDD	N/A(해당 없음)
135W	지원되지 않음	지원되지 않음	20	26	26	28	29	32
130 W	지원되지 않음	지원되지 않음	20	27	27	29	29	33
125W	지원되지 않음	지원되지 않음	21	28	28	30	30	33
115W	지원되지 않음	21	23	29	31	31	32	34
105W	20	23	24	30	33	33	34	35 초과
85W	24	26	27	34	35 초과	35 초과	35 초과	35 초과
70W	25	28	29	35 초과	35 초과	35 초과	35 초과	35 초과

표 11. 인텔 NVMe SSD AIC P4800X 구성 제한 사항

TDP(W)	3.5" 섀시			2.5" 섀시				비 BP 섀시
	12개의 HDD	8개의 HDD	4개의 HDD	24개의 HDD	16개의 HDD	8개의 HDD	4개의 HDD	N/A(해당 없음)
205W	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음
200W	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음
173W	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	20
165W	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	20
160W	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	25
150 W	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	20	20	20	25
140W	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	20	20	20	20	25
135W	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	20	20	20	20	25
130 W	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	20	20	20	20	25
125W	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	20	25	25	25	30
115W	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	25	25	25	25	30
105W	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	25	25	25	25	30
85W	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	30	30	30	30	35 초과
70W	지원되지 않음	지원되지 않음	지원되지 않음	35 초과	35 초과	35 초과	35 초과	35 초과

확대된 작동 온도 사양

표 12. 확대된 작동 온도

확대된 작동 온도	사양
연속 작동	RH 5% ~ 85%에서 5°C ~ 40°C, 최대 이슬점 29°C **노트:** 표준 운영 온도(10°C ~ 35°C)를 벗어나는 경우에도 시스템은 최저 5°C ~ 최고 40°C에서 연속 작동할 수 있습니다.
	온도가 35°C ~ 40°C인 경우 허용되는 최대 건구 온도는 950m 이상의 고도에서 1°C/175m(1°F/319ft)로 감소합니다.
연간 작동 시간의 ≤ 1%	RH 5% ~ 90%에서 -5°C ~ 45°C, 최대 이슬점 29°C **노트:** 표준 운영 온도(10°C ~ 35°C) 범위를 벗어나는 경우에도 연간 작동 시간의 최대 1% 동안 최저 -5°C ~ 최고 45°C에서 시스템을 작동할 수 있습니다.
	온도가 40°C ~ 45°C인 경우 허용되는 최대 건구 온도는 950m 이상의 고도에서 1°C/125m(1°F/228ft)씩 감소합니다.

노트: 확대된 온도 범위에서 작동하는 경우 시스템 성능에 영향을 줄 수 있습니다.

노트: 확대된 온도 범위에서 작동하는 경우 주위 온도 경고가 시스템 이벤트 로그에 보고될 수 있습니다.

작동 온도 정격 감소 사양

표 13. 작동 온도

운영 온도 정격 감소	사양
35°C(95°F) 이하	최대 온도는 950m(3,117ft) 이상에서 1°C/300m(1°F/547ft)씩 감소합니다.
35°C ~ 40°C(95°F ~ 104°F)	최대 온도는 950m(3,117ft) 이상에서 1°C/175m(1°F/319ft)씩 감소합니다.
45°C(113°F) 이상	최대 온도는 950m(3,117ft) 이상에서 1°C/125m(1°F/228ft)씩 감소합니다.

상대 습도 사양

표 14. 상대 습도 사양

상대 습도	사양
보관 시	최대 이슬점이 33°C(91 °F)인 5% ~ 95% RH. 대기는 항상 비응축 상태여야 합니다.
작동 시	10% ~ 80% 상대 습도, 최대 이슬점 29°C(84.2°F).

온도 사양

표 15. 온도 사양

온도	사양
보관 시	–40°C ~ 65°C(–40°F ~ 149°F)

표 15. 온도 사양 (계속)

온도	사양
연속 작동(950m 또는 3117ft 미만의 고도에서)	장비가 직사광선을 받지 않는 상태에서 10°C ~ -35°C(50°F ~ 95°F).
신선한 공기	신선한 공기에 관한 자세한 내용은 확대된 작동 온도 섹션을 참조하십시오.
최대 온도 변화(작동 및 보관 시)	20°C/h(68°F/h)

노트: 일부 구성에는 보다 낮은 주위 온도가 필요합니다. 자세한 내용은 표준 운영 온도 사양을 참조하십시오.

미세 먼지 및 가스 오염 사양

표 16. 미세 먼지 오염 사양

미세 먼지 오염	사양
공기 여과	데이터 센터 공기 여과는 ISO Class 8 per ISO 14644-1의 규정에 따라 95% 상위 지수 제한됩니다.
노트: 이 조건은 데이터 센터 환경에만 적용됩니다. 공기 여과 요구사항은 사무실이나 공장 바닥과 같은 환경인 데이터 센터 외 공간에서의 IT 장비에는 적용되지 않습니다.	
노트: 데이터 센터로 유입되는 공기는 MERV11 또는 MERV13 여과여야 합니다.	
전도성 먼지	공기에는 전도성 먼지, 아연 휘스커, 또는 기타 전도성 입자가 없어야 합니다.
노트: 이 조건은 데이터 센터 및 데이터 센터 외부 환경에 적용됩니다.	
부식성 먼지	공기에는 부식성 먼지가 없어야 합니다.
공기 내 잔여 먼지는 용해점이 60% 상대 습도 미만이어야 합니다.	
노트: 이 조건은 데이터 센터 및 데이터 센터 외부 환경에 적용됩니다.	

표 17. 기체 오염 사양

기체 오염	사양
구리 쿠폰 부식률	ANSI/ISA71.04-2013의 규정에 따라 Class G1당 300Å/월 미만
실버 쿠폰 부식률	ANSI/ISA71.04-2013의 규정에 따라 Class G1당 200Å/월 미만
노트: ≤50% 상대 습도에서 측정된 최대 부식성 오염 수치	

최대 진동 사양

표 18. 최대 진동 사양

최대 진동	사양
작동 시	5Hz ~ 350Hz에서 0.26Grms(모든 작동 방향)
스토리지	10Hz ~ 500Hz에서 15분 간 1.88Grms(6개 측면 모두 테스트)

최대 충격 사양

표 19. 최대 충격 사양

최대 충격	사양
작동 시	최대 11ms 동안 (+/-) x, y, z축으로 24회의 충격 펄스 6G(시스템 각 면에 4회의 펄스).
스토리지	최대 2ms 동안 ±x, y, z축으로 71G의 연속 충격 펄스 6회(시스템 각 측면에 1회의 펄스).

최대 고도 사양

표 20. 최대 고도 사양

최대 고도	사양
작동 시	3048m(10,000ft)
스토리지	12,000m(39,370ft).

Fresh Air 작동

Fresh Air 작동 제한 사항

- TDP가 105W를 넘는 프로세서 지원 안 됨
- PERC 제한 사항이 없는 85W 이하의 프로세서 지원
- 8.89cm(3.5인치) 드라이브 구성 지원 안 됨
- CPU1 소켓의 프로세서에 114mm 방열판 필요
- Kerby-flat OCP 지원 안 됨
- DCS 메자닌 슬롯에 M.2 카드 지원 안 됨
- NVMe SSD 지원 안 됨
- AEP DIMM 및 LRDIMM 지원 안 됨
- 25W를 넘는 PCIe 카드 지원 안 됨
- H730 PERC 및 H330의 105W 프로세서 지원
- 85W 이하 TDP 프로세서에 PERC 제한 없음